

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ASMPT LIMITED
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：0522)

**SMT解決方案分部之
策略方案評估**

ASMPT Limited（「**ASMPT**」或「本公司」）謹此宣布，其正就其表面貼裝技術（「**SMT**」）解決方案分部啟動策略方案評估（「評估」）。評估乃本公司轉型歷程之一部分，亦體現其持續致力於保障所有持份者（包括員工、客戶及供應商）利益之同時，為股東實現價值最大化。

評估旨在識別最有利於支持 SMT 解決方案分部長期增長及成功之潛在機遇，同時使本公司可聚焦於日益增長之半導體（「**SEMI**」）解決方案分部。

評估將考慮 SMT 解決方案分部之一系列選項，可能包括但不限於出售、合營、分拆及上市，或保留並支持 SMT 解決方案分部之戰略發展以確保其長期成功及價值創造。

作為全球市場及技術領導者，SMT 解決方案分部結合深度工藝技術、創新科技、行業領先硬件、軟件及服務解決方案。其獨特之產品組合為汽車、工業、消費電子及半導體終端市場之電子製造及關鍵應用提供集成解決方案，涵蓋從高混合／低產量至高速量產及先進封裝技術。

SMT 解決方案分部之產品組合包括高精度 DEK 印刷機以及強大的 SIPLACE 貼片平台，該平台最近由獲全新設計之創新 SIPLACE V 平台輔助。該解決方案組合輔以一整套全面的軟件解決方案，覆蓋從機器及生產線級別至工廠及企業級別。該分部之製造執行系統（「**MES**」）為一個模組化、可擴展且支援雲端之平台，能與企業系統及工廠自動化解決方案無縫集成。

評估期間，SMT 解決方案分部將繼續如常營運，並始終致力為其客戶提供最優質的產品及服務。

評估並無固定完成時間表，且本公司尚未就任何潛在交易作出決定。無法保證評估將促成任何交易，亦無法確定其時間或條款。

本公司將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則之規定，於必要時作出進一步公告。

摩根士丹利亞洲有限公司就評估擔任本公司獨家財務顧問。

本公司之股東及潛在投資者在買賣本公司證券時應謹慎行事。

承董事會命
ASMP Limited
董事
黃梓達

香港，二零二六年一月二十一日

於本公告日期，本公司董事會成員包括獨立非執行董事：樂錦壯先生（主席）、張仰學先生、蕭潔雲女士及許明麗女士；非執行董事：Hichem M'Saad 博士及 Paulus Antonius Henricus Verhagen 先生；執行董事：黃梓達先生及 Guenter Walter Lauber 先生。

（本公告之中英文版本如有任何歧義，概以英文版本為準。）